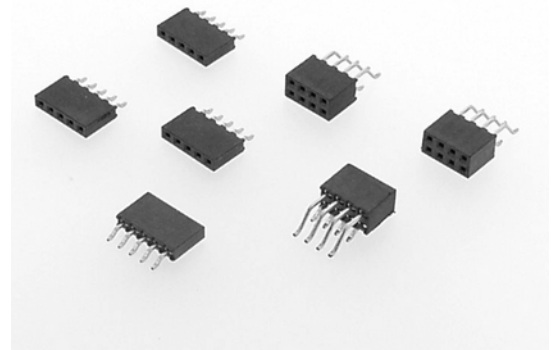


## SMT-Buchsenleisten RM 2,00mm, stehend/liegend, 1-/2-reihig - BH 7,62mm SMT Female Headers, 2.00mm Pitch, Vertical/Horizontal, 1/2 Rows - 7.62mm Profile

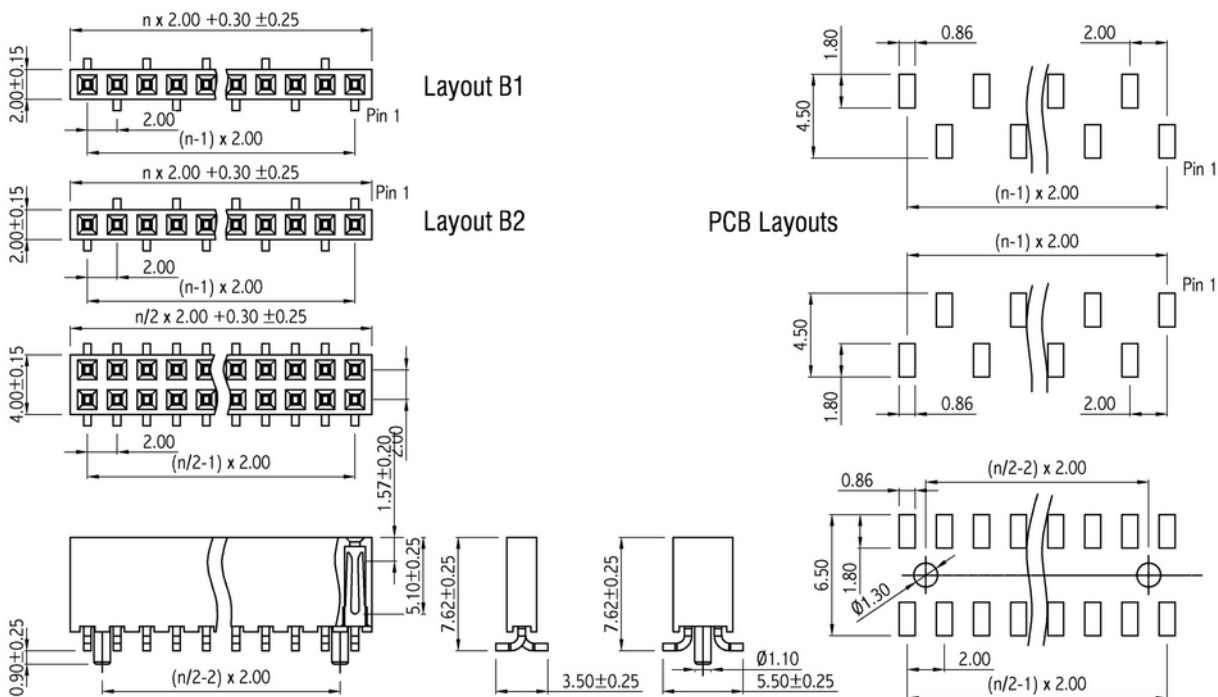
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Contact Material	Phosphor bronze
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

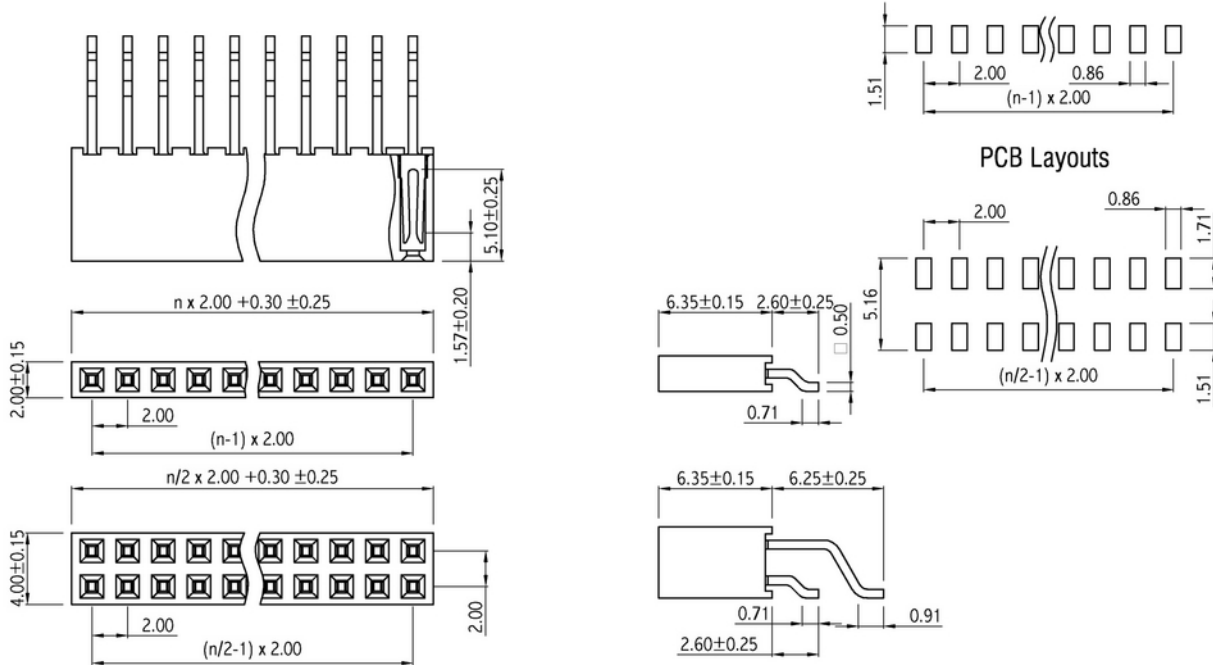
Gabelkontakte für Vierkantstifte 0,50mm.  
Fork contacts accept 0.50mm square pins.



Series	Contacts*	Rows*	Type	Layout*	Plating*	Packaging*
<b>4160</b>	<b>10</b> 02-30 Einreihig Single row 04-60 Zweireihig Double row	<b>2</b> 1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row	<b>1</b> 1 Stehend Vertical	<b>0</b> 1 Layout B1 2 Layout B2 0 (zweireihig) (double row)	<b>50</b> 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex plating	<b>ST</b> ST PPST PPTR

# 4160

SMT-Buchsenleisten RM 2,00mm, stehend/liegend, 1-/2-reihig - BH 7,62mm  
 SMT Female Headers, 2.00mm Pitch, Vertical/Horizontal, 1/2 Rows - 7.62mm Profile



Series	Contacts*	Rows*	Type	Plating*	Packing*
<b>4160</b>	<b>10</b> 02-30 Einreihig Single row 04-60 Zweireihig Double row	<b>2</b> 1 Einreihig Single Row 2 Zweireihig Double row	<b>2</b> 2 Liegend Horizontal	<b>50</b> 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex plating	<b>ST</b> ST TR

#### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pad / In tubes w/o Pick&Place-Pad  
**PPST** In Stangen mit PP-Pad / In tubes with PP-Pad  
**PPTR** Tape & Reel mit P&P-Pad / Tape & Reel with P&P-Pad

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
 \* This is an **order example** - please replace by your specifications.

### Reflow-Löttempfehlung

*Reflow Soldering Recommendation*

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

*Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).*

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

